

深圳丹邦科技股份有限公司

关于全资子公司为公司向银行借款向担保公司提供反担保保证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司为公司向银行借款向担保公司提供反担保保证的议案》，公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金借款人民币 1000 万元，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投”）为该笔借款提供担保，公司全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）就该笔借款向高新投提供反担保保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次反担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、担保公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300571956268F
- 3、成立日期：2011 年 04 月 01 日
- 4、注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元
- 5、法定代表人：刘苏华
- 6、注册资本：500,000 万元人民币
- 7、经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

8、最近一年经审计财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，高新投总资产为 179,466.90 万元，净资产为 136,771.12 万元，2018 年度的营业收入为 16,009.17 万元，净利润为 3,784.22 万元（以上财务数据已经审计）。

9、上市公司及全资子公司广东丹邦与高新投无关联关系。

三、债务人基本情况

1、名称：深圳丹邦科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440300732076027R

3、住所：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼

4、法定代表人：刘萍

5、注册资本：54,792 万元

6、成立日期：2001 年 11 月 20 日

7、营业期限：2001 年 11 月 20 日至长期

8、经营范围：一般经营项目是：开发柔性复合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营柔性复合铜板、液晶聚合导体材料，高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集集成电路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜。

四、反担保的主要内容

1、保证方式：反担保保证责任。

2、担保保证的范围：担保协议书项下债务人应当承担的全部债务。

3、保证期间：担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。

具体内容以签订的相关合同为准。

五、独立董事意见

公司全资子公司广东丹邦科技有限公司就公司向银行申请借款事项向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保保证是根据公司业务发展的需要，有利于

公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司未发生过对外担保事项。公司全资子公司广东丹邦为公司向中国邮政储蓄银行借款人民币3000万元向深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保，累计对外担保 3000 万元（不含本次担保），占公司 2018 年经审计净资产的 1.75%。公司和公司全资子公司不存在违规担保和逾期担保。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2020 年 2 月 17 日